

中国国际金融股份有限公司

关于苏州东微半导体股份有限公司

2025 年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“东微半导”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责东微半导上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与东微半导签订《保荐协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2025年东微半导在持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施	2025年东微半导在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
5	通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解东微半导业务情况，对东微半导开展了持续督导工作
6	督导上市公司及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业	在持续督导期间，保荐机构督导东微半导及其董事、高级管理人员遵守法

序号	工作内容	持续督导情况
	务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所作出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会议事规则以及董事、高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促东微半导体依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对东微半导的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，东微半导的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运营
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促东微半导体严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对东微半导的信息披露文件进行了审阅，不存在上市公司不予更正或补充而应向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2025年，东微半导体及其主要股东、实际控制人、董事及高级管理人员未发生该等情况
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2025年，东微半导体实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2025年，经保荐机构核查，不存在前述应向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司作出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可	2025年，东微半导体未发生该等情况

序号	工作内容	持续督导情况
	能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查要求，确保现场检查工作质量	2025年度，保荐机构制定了现场检查工作计划，并实地进行了现场检查，出具了现场检查报告
16	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现以下情形之一的，保荐人应当自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上交所认为应当进行现场核查的其他事项	2025年，东微半导体不存在需要进行专项现场检查的情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

本持续督导期间，公司面临的主要风险因素如下：

（一）核心竞争力风险

1、技术迭代与研发升级风险

全球能源结构转型与数字经济浪潮叠加，功率半导体作为电能转化和电路控制的核心器件，下游应用十分广泛，包括新能源（风电、光伏、储能和电动汽车）、消费电子、智能电网、轨道交通等，公司需要根据技术发展趋势和终端客户需求不断优化现有产品并研发新技术、新产品，从而保持技术创新性和产品竞争力。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，保持核心技术优势并根据客户需求及时进行技术迭代并推出具有竞争力的新产品，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等可能受到不利影响。

2、专利壁垒风险

国际巨头（如英飞凌、意法半导体等）已构筑严密的专利网络，后发企业可能面临诉讼或高额授权成本的风险。为有效应对该风险，公司知识产权部门与专利事务所开展长期合作，通过系统的专利地图分析，识别风险。在中国、欧洲、东亚等关键市场布局专利申请，逐步构建区域化专利防护体系，从源头降低侵权风险。同时，公司建立并落实知识产权激励机制，鼓励研发人员及时提交技术创新成果，持续充实自主知识产权储备。

3、核心技术泄密与人才流失风险

功率半导体具有技术密集型的显著特征，其核心技术与人才是支撑企业竞争力的关键资产。在激烈的人才竞争下，核心人员的流失可能导致企业技术发展受阻、创新能力断层。此外，尽管已有保密协议和专利保护作为防护屏障，但核心工艺、设计方法等关键技术泄密的风险依然存在，一旦发生，将严重削弱企业的竞争优势。

为应对风险，公司与核心技术人员签订严格的保密协议及竞业限制协议，稳定核心技术团队，提供有市场竞争力的待遇和中长期激励计划，增强人才留任吸引力，同时保持对新人才的引进和培养，降低因技术泄密或关键人才流失对公司持续研发能力可能带来的不利影响。

（二）经营风险

1、供应商集中度较高的风险

公司不直接从事晶圆制造和封装测试等生产和加工环节，该环节委托代工厂完成。由于公司的晶圆供应商集中度较高，若出现晶圆代工行业产能紧张或双方关系恶化的情况，则可能导致公司产品无法按时、足量交付，进而对公司的经营业绩产生不利影响。同时，芯片设计企业与代工及封装测试企业之间一定程度上互相依赖，专注于芯片设计环节的企业在选择供应商后通常不会轻易更换；同样，芯片代工及封装测试企业如若更换客户则需重新调整产线、设备技术参数、产能排期等，这将形成较大的更换成本。因此，针对这一风险，公司将在持续拓展上游供应商渠道的同时，稳固、加深与现有供应商的合作关系。

2、供应链管理风险

公司专注于高性能功率器件的研发与设计，晶圆制造和封装等主要生产环节由专业的晶圆制造和封装厂商完成。报告期内，公司与行业内知名的晶圆制造厂商和封装厂商均建立了长期稳定的合作关系，但由于功率半导体产品交期长、多环节外包导致链条长、协调难等情况，且公司产品的终端应用涵盖了工业、汽车相关应用及消费等多个行业，行业内客户均具有较高的供应商认证要求，如果公司对供应链及生产环节管理不善，导致产品质量、交付及时性等问题出现，则会影响公司产品销售和品牌声誉，对公司的经营造成不利影响。

针对上述风险，公司优先选择行业内的头部供应商进行合作，建立常态化现场审核与质量监控制度；同步布局多家供应商，分散单一依赖风险；强化封装设计与晶圆工艺的协同验证，从源头降低风险。

3、经销商管理不善的风险

公司采用“经销加直销”的销售模式。报告期内，公司主营业务收入中经销收入占比相对较高，为 70.24%，经销商可以帮助公司快速建立销售渠道，提升品牌知名度，也可以协助公司进行终端客户的日常维护和售后服务。未来，如果公司对经销商管理不善，可能造成经销商不能很好地理解公司品牌和发展目标，影响公司声誉，并且导致客户关系疏离，从而对公司业绩带来不利影响。

针对上述风险，公司建立严格的经销商准入制度，考察经销商资质、资金实力、行业经验、客户资源等，择优选择合作经销商，并根据销售规模、市场覆盖、服务能力等对核心经销商给予更优惠的价格、账期与资源支持，对不合格经销商及时淘汰，提升渠道整体质量。定期召开经销商会议，收集市场反馈，及时解决经销商在供货、技术、售后等方面的问题，增强合作信任度。通过长期共赢的合作模式，提升经销商忠诚度，减少渠道流失风险。

4、市场竞争风险

海外巨头厂商如英飞凌、安森美、意法半导体等长期占据高性能功率半导体器件的主要市场，这些企业具有较大的生产规模 and 市场份额，产品线齐全，技术实力雄厚。作为全球最大的应用市场，中国市场对国际厂商来说具有重要的战略

意义，因此国际厂商纷纷不断增加在中国的研发、技术、资本和人员投入，并扩大营销网络和市场布局，以占据中国功率器件市场的优势地位。公司相较于海外品牌，在产品系列、人才体系、供应链资源等方面仍存在一定差距。同时，随着国内功率半导体产业的高速发展和完善，公司面临的现有竞争对手以及本土新进功率半导体器件公司的竞争也愈加激烈。在此背景下，终端客户可能采取向多家供应商分散采购的策略，从而降低企业在终端客户中的采购份额和采购单价。若公司未能根据市场变化及客户需求及时调整竞争策略、进行产品迭代升级和公司客户响应速度，将导致公司在日趋激烈的市场竞争中处于不利地位，可能对公司业绩产生不利影响。

（三）财务风险

1、毛利率波动的风险

公司综合毛利率受产品售价、产品成本以及产品结构等因素影响。公司营业成本主要由材料成本和封测费用构成，其中材料成本以晶圆成本为主，若晶圆价格未来持续提高，可能会对公司的主营业务成本以及毛利率水平造成不利影响。随着行业技术的发展和市场竞争的加剧，公司需要根据市场需求不断进行技术的迭代升级和创新，避免陷入“价格战”，若公司未能正确判断下游需求变化、或公司技术创新停滞不前、或公司未能有效控制产品成本、或公司产品市场竞争格局发生变化等都将导致公司发生产品售价和成本预期外波动等不利情形。在该等不利情况下，公司综合毛利率水平未来可能会存在持续波动、下降的可能性，从而对公司的经营带来一定风险。此外，公司的产品规格数量较多，不同规格的产品销售结构的变化亦会对公司的毛利率造成影响。

2、应收账款增加的风险

报告期末，公司应收账款账面价值为 15,514.40 万元，公司按照会计政策对应收账款计提坏账准备，但未来应收账款可能会随着经营规模的扩大而继续增长。若主要债务人的财务状况、合作关系发生恶化，或催收措施不力，则可能导致应收账款及应收票据无法收回形成坏账损失，对公司经营成果造成不利影响，也会影响公司经营性现金流量，对公司资金状况造成不利影响。

3、存货减值的风险

报告期末，公司存货的账面价值为 54,789.84 万元，公司存货账面价值随着业务规模的增长有所增加。公司存货的可变现净值受到下游市场情况变动的的影响，未来，如果公司下游客户需求、市场竞争格局发生变化，或者公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理，可能导致存货无法顺利实现销售，公司或将面临存货减值的风险，进而会给公司经营造成一定的不利影响。

（四）行业风险

1、产业政策变化风险

功率半导体产业作为信息产业的基础，是国民经济和社会发展的战略性产业。近年来，国家出台了一系列鼓励政策以推动我国半导体产业的发展，增强中国半导体产业创新能力和国际竞争力。国家持续推出了各项支持半导体行业发展的政策，包括《中国制造 2025》《国家信息化发展战略纲要》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（“十四五规划”）。在《关于推动能源电子产业发展的指导意见》中明确“加快功率半导体器件等面向光伏发电、风力发电、电力传输、新能源汽车、轨道交通推广”。未来，如果国家相关产业政策支持力度减弱，将不利于国内功率半导体行业的技术进步，将可能对公司的经营业绩造成不利影响。

2、下游需求波动及新兴应用领域发展不及预期的风险

半导体行业具有较强的周期性特征，其景气周期与宏观经济、下游应用需求以及产能库存等因素紧密相关。因此，若驱动公司收入实现增长的下游行业发展不达预期，行业规模增速放缓或出现下滑，中国功率半导体行业进口替代趋势放缓，下游行业的波动和低迷会导致客户对成本和库存更加谨慎，公司产品的销售价格和销售数量均会受到不利影响。

功率器件在机器人、AI 算力服务器、高速通信等新兴赛道的落地应用与产业发展具备广阔空间，但同时面临多重不确定性风险。一方面，相关产业政策、行业监管规则若发生调整，将直接影响行业发展环境；另一方面，若新兴应用领域整体发展进度不及预期、下游需求疲软，也会制约功率器件产品的市场渗透与规模化应用，进而对行业发展带来不利影响。此外，若公司在以上新兴领域的相

关研发推进不及预期、技术迭代及产品落地进展不顺，同样可能拖累相关业务布局，进而对公司经营发展带来不利影响。

3、功率半导体周期性波动风险

受到全球宏观经济的波动、行业景气度等因素影响，功率半导体行业存在一定的周期性变化。功率半导体器件广泛应用于工业制造、新能源、汽车电子、通信运输、消费电子等国民经济各个领域，如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，导致功率半导体行业处于低迷状态，则功率半导体行业的市场需求可能发生萎缩，进而影响公司的经营业绩和盈利能力。

（五）宏观环境风险

1、贸易保护主义风险

近年来，全球贸易保护主义壁垒高筑，地缘政治冲突和国际贸易摩擦频发，国际贸易摩擦不断，部分国家通过贸易保护加技术封锁的手段，试图制约中国相关产业的发展，国际贸易政策存在一定的不确定性。公司始终严格遵守中国和他国法律，但国际局势瞬息万变，一旦因国际贸易摩擦导致公司业务受限、供应商无法供货或者客户采购受到约束，公司的正常生产经营将受到不利影响。如果全球贸易摩擦进一步加剧，境外客户可能会减少订单、要求公司产品降价或者承担相应关税等措施，境外供应商可能会被限制或被禁止向公司供货。若出现上述情况，则公司的经营可能会受到不利影响。

2、税收优惠政策变动风险

公司享受的税收优惠主要包括高新技术企业所得税率优惠、研发加计扣除等。公司系高新技术企业，于2024年11月获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年。报告期内公司按15%的税率征收企业所得税。如果未来未能再次取得高新技术企业资质，或者所享受的其他税收优惠政策发生变化，将会对公司业绩产生一定影响。

四、重大违规事项

2025年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2025 年度，公司主要会计数据如下：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减(%)	2023 年
营业收入	1,252,687,576.17	1,003,220,024.79	24.87	972,850,306.19
利润总额	33,252,628.14	33,134,010.37	0.36	150,242,479.08
归属于上市公司股东的净利润	46,210,361.99	40,235,142.44	14.85	140,024,955.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,897,108.68	2,319,303.55	240.49	119,415,124.50
经营活动产生的现金流量净额	-191,729,236.38	-88,313,182.06	不适用	70,547,211.26
主要会计数据	2025 年末	2024 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2023 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,956,604,258.30	2,899,743,730.12	1.96	2,862,140,980.04
总资产	3,119,248,864.05	3,099,883,346.78	0.62	3,011,763,533.44

2025 年度，公司主要财务指标如下：

主要财务指标	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减(%)	2023 年
基本每股收益（元 / 股）	0.38	0.33	15.15	1.14
稀释每股收益（元 / 股）	0.38	0.33	15.15	1.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.06	0.02	200.00	0.97
加权平均净资产收益率（%）	1.58	1.40	增加 0.18 个百分点	4.92
研发投入占营业收入的比例	7.37	7.55	减少 0.18 个	8.74

主要财务指标	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减(%)	2023 年
(%)			百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.27	0.08	增加 0.19 个百分点	4.20

2025 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 240.49%，主要系报告期内，公司积极优化产品组合策略，进行工艺平台迭代升级，持续开拓新兴市场，通过不断深化与上下游优秀合作伙伴的合作，持续扩大产能。公司主营产品广泛应用于以 5G 基站电源及通信电源、数据中心和算力服务器电源、工业照明电源、车载充电机、新能源汽车直流充电桩、光伏逆变及储能、车身加热和平衡系统等为代表的工业级与汽车级领域。报告期内，受前述应用领域需求回暖、产能持续扩大、新产品不断推出及产品组合结构进一步优化等因素影响，公司营业收入和毛利率有所上升，盈利能力提升所致。

报告期内，公司实施了限制性股票激励计划，本报告期内摊销的股份支付费用为 1,393.16 万元，若剔除股份支付费用的影响，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 6,014.20 万元，较上年同期增长 49.48%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,182.87 万元，较上年同期增长 841.18%。

2025 年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所减少，主要系报告期内，公司经营规模有所扩大，购买商品、接受劳务支付的现金有所增加所致。

2025 年度扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长 200.00%，主要系报告期内，公司经营规模有所扩大，盈利能力提升，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅增长所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）强大的研发能力

公司一直以来高度重视研发团队及体系的建设，完整的研发团队及体系与持续的研发投入使得公司成为功率器件领域产品性能领先的本土企业之一。公司的核心技术人员均在功率半导体领域耕耘超过十年，具有丰富的研发经验，并对行

业未来的技术发展趋势具有前瞻性的创新能力。公司核心技术研发能力保证了公司的技术敏锐度和研发水平，确保了公司的产品迭代能够紧跟行业发展趋势，亦满足客户终端产品的创新需求。公司的市场、运营、销售等部门的核心团队均拥有半导体行业相关的学历背景和国内外知名半导体公司多年的工作经历，积累了丰富的产业经验和专业的管理能力。

同时，公司的研发管理体系与质量体系持续改进，多个数字化系统的功能得以优化。公司自研的新一代产品生命周期管理系统的上线，进一步推动研发效率的提升。

（二）丰富的产品规格

功率器件的产品规格丰富，不同规格的产品被应用于不同的应用场景。得益于公司丰富的产品系列以及强大的产品开发能力，公司的功率器件产品已被广泛应用于各类工业级及消费级领域。

同时，公司车规产品管理评审流程日渐成熟，车规产品推出速度和数量大为提升，车规市场项目的对接成功机会显著增加。

（三）广泛的客户基础

凭借优异的技术实力、产业链深度结合能力和客户创新服务能力，公司已经与国内外各行业的龙头客户建立了长期的合作关系。在各类功率器件应用领域尤其是车规级和工业级应用领域中，公司的产品获得了众多知名企业的认可，成为了该等客户的主要国内供应商之一。同时，公司在全球范围内积累了众多的知名终端品牌客户。公司进入该等客户的供应链体系后能够持续为公司带来高粘性，同时也将推动公司不断进行技术迭代升级以满足引领行业发展的头部客户需求，为公司保持高端功率器件领域的领先地位奠定基础。

（四）稳定的供应商关系

公司与行业上游的晶圆制造厂商、封装测试厂商等供应商建立了长期稳定的业务合作关系与高效的联动机制。基于与供应商长期稳定的战略合作关系，在根据终端市场需求精确调整产品设计的同时，公司具有与上游供应商合作并实现深度定制化开发的能力。由于功率器件的制造工艺较为特殊，特别是高性能产品的

开发需要器件设计与工艺平台的深度结合，研发团队需对晶圆厂的基准工艺平台进行深度优化和定制设计。在产品研发阶段，公司会与晶圆厂进行深度的共同讨论，通过多次反复工艺调试，使得晶圆厂的工艺能更好地实现公司所设计芯片的性能，最终推出经优化的产品，更好地贴合终端客户的需求。在这个过程中，晶圆代工厂的工艺能力亦在双方互相协作中获得优化和提升，实现了双方技术能力的相互促进和提升。

（五）严格的质量管控

公司高度重视产品质量的可靠性，始终坚持高标准的质量要求。从产品的研发到生产的过程中，坚持严格的质量管控，为客户提供稳定可靠的产品。公司秉承着质量管理体系化的理念，构建了全面质量管理体系，通过“全流程监控-全流程透明-全流程可追踪”的原则，覆盖公司所有关键流程，确保质量管理体系的全面落实和执行。

七、研发投入变化及研发进展

公司深耕高性能功率器件的研发与设计领域，作为电能转换与控制的核心元件，产品广泛应用于多种电力电子系统。目前，公司在硅基器件、第三代半导体及功率模块等关键方向上已构建起多项核心技术壁垒，并成功将这些技术全面应用于公司的主营产品中，实现了技术与产品的深度融合。公司坚持技术创新与研发投入，夯实现有产品的技术升级，加快实现新产品的技术迭代。2025 年度研发费用为 9,231.76 万元，较上年同期增长 21.93%；截至 2025 年末，公司研发人员数较上年同期增长 13.04%。

2025 年度，公司新增知识产权申请项目 29 个，其中境内发明专利申请数 24 个；新增知识产权授权项目 21 个，其中境内发明专利 10 个，境外专利 10 个，集成电路布图 1 个，具体如下表所示：

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	24	10	178	70
实用新型专利	0	0	3	3

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	0	0
其他	5	11	220	106
合计	29	21	401	179

注：本年新增其他申请数为 5 个，其中境外专利 3 个、集成电路布图 2 个；本年新增其他获得数 11 个，其中境外专利 10 个、集成电路布图 1 个；累计其他申请数为 220 个，其中 PCT 专利 77 个、境外专利 107 个、中国商标 31 个、集成电路布图 4 个、马德里商标 1 个；累计其他获得数为 106 个，其中境外专利 86 个、中国商标 16 个、集成电路布图 3 个、马德里商标 1 个。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况是否合规

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州东微半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4040号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票16,844,092股，发行价格为每股人民币130.00元，募集资金总额为人民币218,973.20万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币18,317.54万元后，实际募集资金净额为人民币200,655.66万元。上述募集资金已全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年1月28日出具《验资报告》（天健验〔2022〕42号）。

公司2025年度募集资金使用具体情况如下：

单位：人民币万元

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年1月28日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额

一、募集资金总额	218,973.20
其中：超募资金金额	106,786.56
减：直接支付发行费用	18,317.54
二、募集资金净额	200,655.66
减：	
以前年度已使用金额	138,695.69
本年度使用金额	40,527.18
节余募集资金永久补流金额	6,975.34
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0
其他-具体说明	/
加：	
募集资金利息收入净额	7,448.80
其他-具体说明	/
三、报告期期末募集资金余额	21,906.25

截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

发行名称			2022 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022 年 1 月 28 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
苏州东微半导体股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	75250122000318288	195,662,643.63	使用中
苏州东微半导体股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801200006972	0	使用中

发行名称			2022年首次公开发行股份	
苏州东微半导体股份有限公司	交通银行股份有限公司苏州科技支行	325060700013000751708	0	使用中
苏州东微半导体股份有限公司	苏州银行股份有限公司工业园区支行	51549300001103	23,399,883.68	使用中
苏州东微半导体股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001011868888888	0	使用中
苏州东微半导体股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州独墅湖支行	512906076910302	0	使用中

1、闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年2月22日，公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币100,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2025年2月20日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下，使用额度最高不超过人民币67,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，到期后将归还至公司募集资金专项账户。

截至2025年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理均已到期赎回。

2、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营。公司超募资金总额为 106,786.56 万元，本次用于永久补充流动资金的金额为 30,000.00 万元，占超募资金总额的比例为 28.09%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%。在补充流动资金后的 12 月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额为 90,000.00 万元。

3、节余募集资金使用情况

公司于 2025 年 9 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至 2025 年 8 月 31 日，公司募集资金投资项目之“研发工程中心建设项目”已达成预定可使用状态，同意予以结项。为提高募集资金使用效率，合理分配资源，提升公司的经营效益，公司将该项目节余募集资金用于永久补充流动资金。

该项目实际节余资金（含利息收入）共计 61,257,025.06 元。节余资金主要来源于项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用管理的相关规定，秉持节约、合理、高效的原则，在保障项目质量并有效控制实施风险的前提下，加强各环节费用的管控与监督，通过对各项资源的合理调度与优化配置，有效降低了项目建设成本与费用支出，从而形成资金节余。

（二）募集资金合规情况

公司 2025 年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规

范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东，实际控制人为王鹏飞及龚轶，股东卢万松为王鹏飞及龚轶的一致行动人。

截至 2025 年 12 月 31 日，王鹏飞直接持有公司 12.09% 的股份，并通过作为苏州工业园区高维企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人间接控制公司 3.32% 的股份；龚轶直接持有公司 9.99% 的股份，并通过作为苏州工业园区得数聚才企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人间接控制公司 2.11% 的股份；王鹏飞和龚轶的一致行动人卢万松直接持有公司 3.57% 的股份。因此，王鹏飞和龚轶直接或间接控制及通过一致行动安排合计共同控制了公司 31.08% 的股份，系公司的实际控制人。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际控制人、董事和高级管理人员持有的股份不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

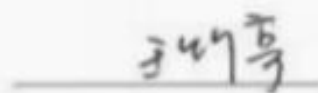
（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于苏州东微半导体股份有限公司2025年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：



李扬



王竹亭

